

LASER X



半自动共晶机

产品特性

- 放置精度 $\pm 1.5\mu\text{m}$ (3σ)
- 能够处理微小芯片
- 应用LD与 Submount 共晶焊接

性能参数

	参数	规格
芯片	适用的产品类型	COC
	芯片尺寸	$0.15\text{mm} < \text{芯片尺寸} < 1.5\text{mm}$
	基板尺寸	$0.15\text{mm} < \text{基板尺寸} < 4\text{mm}$
速度	生产周期时间 (1个芯片)	70秒
精准度	贴片压力	10g~100g
	放置准确度	$\pm 1.5\mu\text{m}@3\sigma$ (芯片 $<1\text{mm}$)
	芯片角度	$0.3\text{deg}@3\sigma$
相机	相机传感器分辨率	3072x2048
	相机视野	1.8x1.2(4x lens)
共晶台	最高温度	450度 (最短升温时间1.5s)
	加热方式	脉冲加热
	加热速度/冷却速度	$\leq 100^\circ/\text{Sec}$
	温度控制精度	$\pm 5^\circ$
电气规格	保护气体	氮气
	电源	220VAC/50Hz
设备尺寸与重量	能量消耗	3.5kVA
	空气	4 ~ 6Kgf/cm ²
	尺寸	500x500x800 (mm)
	重量	100kg